

## EV Group and ITRI to expand advanced heterogeneous integration process development – September 2, 2022

EV Group攜手工研院 擴大先進異質整合製程開發

蘇嘉維／台北報導

2022.08.31

微機電系統（MEMS）、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備之領導廠商EV Group（EVG），今日宣布攜手工業技術研究院（以下簡稱工研院）擴大先進異質整合製程的開發。

在半導體製造中，隨著超越電晶體微縮的更高效能需求提升，3D垂直堆疊與將多種不同的組件與晶粒，從製造、組裝到封裝至單一設備或封裝中的異質整合封裝技術，也促成了高頻寬互連，以提升整體系統的效能，更成為AI人工智慧、自動駕駛與其它高效能運算應用的關鍵驅動力。

經濟部多年前就看到此前瞻技術的發展潛力，積極推動「人工智慧晶片異質整合模組前瞻製造平台」及「可程式化異質3D整合」等國家級的研發專案；並支持工研院成立異質整合小晶片系統封裝聯盟（Heterogeneous Integration Chip-let System Package Alliance；Hi-CHIP），協助打造包括封裝設計、測試與驗證，及試產生產的完整生態系，已逐步達成供應鏈在地化的目標，更成功擴展商機。

由於EVG是Hi-CHIP聯盟成員之一，多套EVG最先進的晶圓接合與微影系統，包括LITHOSCALE 無光罩曝光微影系統、EVG850 DB自動化剝離系統及GEMINI FB混合接合系統將於2022年底前進駐工研院3D-IC實驗室；未來將工研院的先進設備導入量產平台後，將協助雙方的共同客戶加速開發全新異質整合製程，拓展至客戶端的晶圓廠。

工研院電子與光電系統研究所副所長駱韋仲表示，工研院的使命為帶動工業發展、創造經濟價值並透過科技的研發增進社會福祉，長期以來持續開發全新3D與異質晶片整合製程，並為供應鏈打造更緊密的合作關係，推進半導體產業持續發展與成長。

工研院的全自動化量產系統與合作業者的晶圓廠規格相同，包括來自EVG的全新晶圓接合與微影解決方案，有利於業者立即將工研院開發的製程配方導入生產過程，加速從實驗室到晶圓廠量產上市時程。

<https://ctee.com.tw/livenews/kj/ctee/A05622002022083111090420>